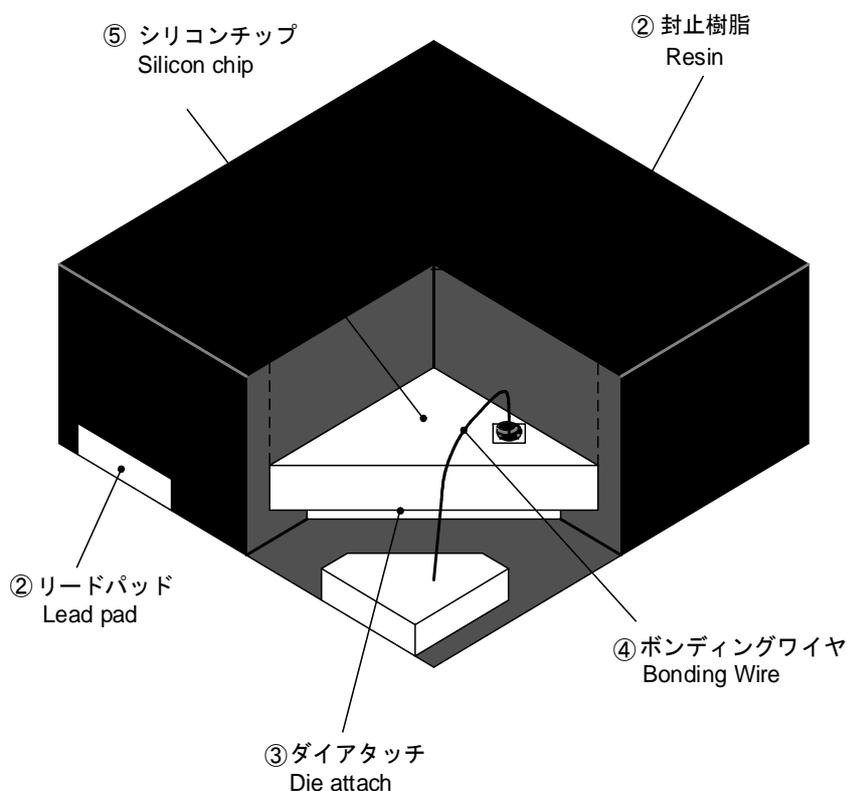


USPQ-4B04構造図
USPQ-4B04 Perspective

RoHS対応品
 RoHS Compliance



| 項目 item | 材料 material | 備考 Note |
|------------|--|--|
| ① | 封止樹脂 resin エポキシ樹脂 Epoxy resin | 難燃グレード/Flammability rating UL94V-0 |
| ② | リードパッド Lead pad ニッケル Nickel | 端子側面は除く Except the side of the terminals. |
| | 端子処理 outer pad plating Auメッキ Gold plating | |
| ③ | ダイアタッチ Die attach エポキシ Epoxy | |
| ④ | ボンディングワイヤ Bonding wire Au | |
| ⑤ | シリコンチップ Silicon chip Si | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 捺印表示 marking | レーザー laser marking |
|-----------------|-----------------------|